

★★★<第14回知的財産翻訳検定試験【第8回和文英訳】>★★★

<<1級課題-電気・電子工学->>

【解答にあたっての注意】

1. 課題は3題あります。それぞれの課題の指示に従い、3題すべて解答してください。
2. 解答語数に特に制限はありません。
3. 課題文に段落番号がある場合、これを訳文に記載してください。

[問1] 以下の文を英訳して下さい。

- (1) 1. 少なくとも1つのLEDからなる単色LED群を有するLED照明器具の光出力を制御する装置であって、
前記LED群から放射される光を受け取るよう構成されたスペクトルフィルタと、
前記フィルタに光学的に接続され、前記フィルタを通過した光を検出して、検出信号を生成する光検出器と、
前記光検出器に接続され、少なくとも部分的に前記検出信号に基づいて前記LED群の光出力を制御する制御モジュールと、
前記フィルタによって受け取られるLED光の入射角を制限する入射角制限部と、
を有する装置。
2. 前記入射角制限部が前記フィルタに位置合わせされた光透過部を含む請求項1に記載の装置。
3. 前記検出信号が前記制御モジュールに入力されると、前記制御モジュールは前記LED群に付設されたランプを点灯させる請求項1に記載の装置。

- (2) 1. 半導体装置の製造方法であって、
所定の厚さを有する基板を準備するステップと、
前記基板を第1の温度に加熱するステップと、
前記基板の上に、前記第1の温度より高い第2の温度に加熱された、貫通電極を各々が備える複数の半導体チップを順次積層することによって積層体を形成するステップと、
前記積層体上に、前記複数の半導体チップのうち最も厚い半導体チップよりも厚い補強部材を設けるステップと、
前記基板、前記積層体及び前記補強部材を常温まで冷却するステップと、
を含む半導体装置の製造方法。
2. 前記準備するステップと前記加熱するステップの間に、前記基板の下面に別の基板を接着するステップをさらに有し、前記別の基板の軟化点は500℃以上である請求項1記載の方法。

[問2] 下記の文を、米国出願用英文明細書における背景技術記載の文章として英訳して下さい。

従来、液晶パネル（液晶セルアレイ）と、画像信号に基づいて当該液晶パネルを駆動させ、当該画像信号に応じた画像を形成させる駆動装置（データ線駆動回路及び行駆動回路）とを備える画像表示装置が知られている（例えば、特許文献1参照）。ここで、液晶パネルは、一方の透光性基板間に配向膜を介して液晶材料が封入された構成を有し、当該一方の透光性基板の外側には偏光板が設けられる。これら一方の透光性基板のうち、一方の透光性基板は、液晶を駆動するための駆動基板（アレイ基板）であり、複数の走査線と、複数のデータ線（信号線）と、これら走査線及びデータ線の交差部位に応じて配置されるTFT（Thin Film Transistor）等のスイッチング素子と、当該スイッチング素子を介してデータ線から画素電極電圧が印加される画素電極とを有する。また、他方の透光性基板は、対向電極を有する対向基板であり、当該対向電極には対向電極電圧が印加される。

[問3] 下記の文を米国出願用英文明細書における実施例記述の文章として英訳して下さい。

本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。なお、上記した従来技術と同じ構成部分については、同一符号を付して詳細な説明は省略する。図1は、本発明の実施形態に係る非接触式ICカードの構成を示すブロック図、図2は、カード本体を上向きにしたときの断面図、図3はカード本体を下向きにしたときの断面図である。図1に示すように、この非接触式ICカードは、カード状の外形をなす基板としてのカード本体1の面に設けられた電磁誘導アンテナコイル2と、この電磁誘導アンテナコイル2と回路配線（フィルム状の金属配線3）を介して接続されたICチップ6と、このICチップ6と電磁誘導アンテナコイル2とを接続する金属配線3を、利用者の操作による入・切事象の発生で導通または非導通させるスイッチ7とを備えている。非接触式ICカードは、一般に、密着型（通信距離0～2mm、使用周波数4.91MHz）、近接型（通信距離0～10cm、使用周波数13.56MHz）、近傍型（通信距離0～70cm、使用周波数13.56MHz）に分類されるが、本発明はいずれの場合にも適用可能である。